DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) 1998 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

02125666 THIN FILM TRANSISTOR

PUB. NO.: **62-042566** [JP 62042566 A]

PUBLISHED: February 24, 1987 (19870224)

HIRANAKA KOICHI

INVENTOR(s): YOSHIMURA TETSUZO

YANAGISAWA SHINTARO

APPLICANT(s): FUJITSU LTD [000522] (A Japanese Company or Corporation),

JP(Japan)

APPL. NO.: 60-182229 [JP 85182229] FILED: August 20, 1985 (19850820)

INTL CLASS: [4] H01L-029/78; H01L-021/20; H01L-021/314; H01L-

027/12; H01L-029/161

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD: R096 (ELECTRONIC MATERIALS -- Glass Conductors); R097

(ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors, MOS)

JOURNAL: Section: E, Section No. 525, Vol. 11, No. 224, Pg. 105, July 21, 1987 (19870721)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain a thin film FET which has an active layer transparent for visible light and has little dark current by laminating thin films of amorphous SiC:H, Ge or the like and thin films of amorphous Si:H alternately.

CONSTITUTION: An NiCr gate electrode 2 is formed on a glass substrate 1. Laminated layers 4 composed of amorphous Si:H 41 and amorphous SiC:H 42 are piled on an Si(sub 3)H(sub 4) film 3 to form an active layer. A Ti layer 6 and an Al layer 7 are laminated to form a source electrode 8 and a drain electrode 9. In order to reduce the resistance of the active layer, the concentration in the laminated layers are controlled by introducing impurities into the amorphous Si:H layers only which have excellent doping characteristics. With this constitution, an active layer transparent for visible light can be obtained and misoperation caused by the unexpected absorption of visible light can be avoided. Moreover, as the current flows in the amorphous Si:H layers owing to the carrier confinement effect of a super-lattice, an FET with a high mobility and high operation speed can be obtained.

19日本国特許庁(JP)

の 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 42566

@Int_Cl_1 識別記号 庁内整理番号 ④公開 昭和62年(1987)2月24日 H 01 L 29/78 8422-5F 7739-5F 21/20 21/314 6708-5F 27/12 7514-5F 29/161 8526-5F 審査請求 発明の数 1 未請求 (全4頁)

図発明の名称 薄膜トランジスタ

> ②特 顋 昭60-182229

出の 阻 昭60(1985) 8月20日

伊発 眀 者 川崎市中原区上小田中1015番地 吉 村 徹 富士通株式会社内 73発 明 者 平 4 弘 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 明 73発 者 柳 川崎市中原区上小田中1015番地 沢 真太郎 富士通株式会社内 印出 顖 人

川崎市中原区上小田中1015番地

砂代 理 弁理士 井桁 貞一

富士通株式会社

1. 発明の名称

 \cdot

薄膜トランジスタ

2. 特許請求の範囲

水素化アモルファス炭化シリコンと水素化アモ ルファス窒化シリコンと水素化アモルファスゲル マニウム化シリコンと水素化アモルファス酸化シ リコンとよりなるグループから選らばれた一つの 物質の薄膜(12)と水素化アモルファスシリコン の薄膜(41)とを交互に積層してなる非品質半導 体薄膜積層体(4)を活性層とする薄膜トランジ スタ.

3 . 発明の詳細な説明

(概要)

強限トランジスタの改良である。

活性層を、水素化アモルファス炭化シリコン、 水素化アモルファス窒化シリコン、水素化アモ ルファスゲルマニウム化シリコン、水業化アモル ファス酸化シリコン等の薄膜 42と水素化アモル ファスシリコンの薄膜川とを交互に技勝してなる

非 品 貫 半 導 体 庫 膜 後 暦 体 4 と す る こ と に よ り 、 これを可視光に対して透明とし、遮光板等を必要 とすることなく、暗電流を減少し誤動作等の発 生を防止しうるようにした意識トランジスタで **a** a .

〔産業上の利用分野〕

本発明は、薄膜トランジスタに関する。特に、 可視光に対して透明の活性層を使用して、暗電 旋を減少し誤動作等の発生を防止する改良に関 する.

〔従来の技術〕

態限トランジスタは、ガラス基板等非品質基板 の上に形成されることが一般であるから、非品質 半導体である水素化アモルファスシリコン膜を活 性層とする場合が一般である。

(発明が解決しようとする問題点)

ところが、水果化アモルファスシリコンはパン

ドギャップが約1.8eVであり、可視光を吸収するから、 号光としては赤外光より及波及の光を使用しても、不所望の可視光を吸収して暗電波を生じ、さらには異動作のおそれがある。

この欠点を解消するには、バンドギャップが大 きな非晶質半導体を活性層とすればよい。この姿 額に応える非晶質半導体としては、水素化アモル ファス炭化シリコン、水素化アモルファス窒化シ リコン等があるが、これらにあっては、キャリヤ のモビリティーが低く、抵抗率が大きいから、 抵抗率を低下するために不純物を導入することが 望ましいが、このために不純物を導入すると、 トラップが増加する等して電気特性が損なわれ る。水素化アモルファス炭化シリコン、水素化ア レファス窒化シリコン等のドーピング特性が悪 いからである。そこで、従来技術においては、活 性層としては水素化アモルファスシリコンを使用 し、これに直光板を併用することが一般であり、 可視光に対して透明な活性層よりなる薄膜トラン ジスタの開発が望まれていた。

この 非晶質 半導 体は パンドギャップの 制御 が容易であることに 加えて、ドーピング 特性のすぐれている 利点も 有するから、 毎膜トランジスタの活性 暦として 利用するとき、 不純物を導入して 低低抗とすることができる。 水素化 アモルファス 度化シリコン、 水素化 アモルファス 窒化シリコン、

本発明の目的はこの契請に応えることにあり、 可及光に対して透明な話性層を有し、略電流が少なく不所望の可視光吸収にもとづき調動作等をす ることのない種膜トランジスタを提供することに ある。

(問題点を解決するための手段)

上記の目的を達成するために本発明が採った手段は、水素化アモルファス炭化シリコン、水素化アモルファス酸化シリコン、水素化アモルファス酸ゲルマニウム化シリコン、水素化アモルファス酸化シリコン等の離膜42と水素化アモルファスシリコンの薄膜41とを交互に設置してなる非晶質半導体薄膜设置体4をもって活性層を形成することにある。

(作用)

本発明は、アモルファススーパーラティスのバンドギャップが、量子井戸の深さと幅とキャリヤである電子または空孔の有効質量との関数として

案化アモルファスゲルマニウム化シリコン、水業化アモルファス酸化シリコン等はドーピング特性が悪いためドープできないが、水素化アモルファスシリコンはドーピング特性がすぐれているので、水素化アモルファスシリコンのみに不純物を導入しては層体の不純物濃度を制御しうるからである。

(実施例)

以下、図面を参照しつい、本発明の一実施例に係る薄膜トランジスタについてさらに説明する。

第2图参照

ガラス塩板等1上にニッケルクローム等の導電体膜を厚さ約 1.000人に形成した後、これを幅約20mm にパターニングしてゲート電極2を形成する。

第3図参照

高周波グロー放電分解法を使用して、厚さ約 3.000 A の窒化シリコンの膜(ゲート絶縁膜) 3 と、上記せる水素化アモルファスシリコン、水業化アモルファス炭化シリコン、水素化アモルファス炭化シリコン、水素化アモルファス酸化シリコン、水素化アモルファス酸性・4 と、リコン等の薄膜 42との後層体 4 と、リンの移動・一プされた水素化アモルファスシリコンの移動・2 とをつづけて形成する。後層体 4 を填え全体の厚さは 5 ~ 50 Å であるが、 後層体 4 全くの原さは約 1.000 Å とする。 りンが降 5 の厚されることになる。リンが降 5 の厚されることになる。リンが降 5 の厚された水素化アモルファスシリコンの薄膜 5 の厚された水素化アモルファスシリコンの薄膜 5 の厚さは約 100 Å である。

.

この工程は、水素をもって希釈されたモノシランと、メタンとモノシランとの混合ガスとを、順 必切り換えてなす高周波グロー放電分解法を使用 すれば可能である。

第4図参照

厚さ約 1.000 Åのチタン膜 6 と厚さ約 2.000 Åのアルミニウム膜 7 とを形成する。この工程は通常の真空底者法、スパッタ法等を使用して可能で

4 . 図面の簡単な説明

第1回は、本発明の一実施例に係る薄膜トランジスタの新面図である。

第2~4 図は、本発明の一実施例に係る薄膜トランジスタの製造工程図である。

1・・・ガラス基板、 2・・・ゲート電極、

ある.

ゲート電極 2 と対向する領域から膜 5 、 6 、 7 。を、解約 15~ 20 μ m に飲去してソース電極 8 ・ド ・レイン世極 9 を形成する。

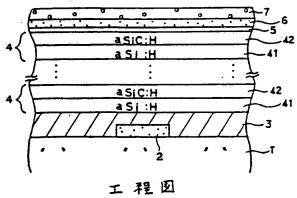
以上の工程をもって製造された薄膜トランジスタの活性層のパンドギャップは水素化アモルファスシリコンのパンドギャップより大きいので、可及光を吸収することはなく、暗電液が流れたり、不所望の可及光を吸収して異動作することはない。

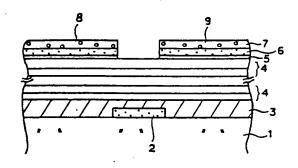
(発明の効果)

以上説明せるとおり、本発明に係る薄膜トランジスタの活性層は水素化アモルファス炭化シリコン、水素化アモルファス窒化シリコン、水素化アモルファスがルマニウム化シリコン、水素化アモルファス酸化シリコン等の薄膜と水素化アモルファスシリコンの薄膜とを交互に積層してなる非晶質半導体薄膜積層体をもって構成されており、最子効果によってそのバンドギャップは自由に調

3 ・・・窒化シリコンの膜(ゲート絶縁膜)、
4 ・・・ 磁層体、 41・・・水素化アモルファス
シリコンの薄膜、 42・・・水素化アモルファ
ス炭化シリコン、水素化アモルファス窒化シリコン、水素化アモルファスがルマニウム化シリコン・水素化アモルファス酸化シリコン等の薄膜、
5 ・・・リンがドープされた水素化アモルファス
スシリコンの薄膜、 6 ・・・チタン膜、
フ・・・アルミニウム膜、 8 ・・・ソース 電極、9・・ドレイン電極。

化理人 非阻止 非抗百二





本彩明 M

